



# Technical Data Sheet

## EXBOND 1515W

### 产品描述

广泛应用于功率放大器、晶体管、电子管和 CPU 等电子元器件导热和散热, 从而保证电子仪器、仪表等电气性能的稳定  
性。

### 特性

脂膏状, 低油离  
度, 优异电绝缘  
性, 优异导热性,  
耐高低温, 耐水,  
耐气候老化等;  
便于辊涂, 与塑料、金属和陶瓷具有极好的粘结性。

### 技术指标

性能	单位	技术参数
热阻抗	C-IN\W	0.15
绝缘常数	-	6
导热系数	W\MK	1.5
针入度	MM\10	340
比重	-	2.1
油离率	-	0.01
体积电阻率	T Ω · M	2.3
工作温度	℃	-50—200

上述数据仅可视为产品标准值, 不应当作为技术规格使用。

## 使用说明

- ◎在贮运和使用过程中，请保持干净，严防灰尘污染。
- ◎请勿与其他油品混用。
- ◎导热硅脂使用不是涂得越多越好，而是在保证填满热传导界面的间隙前提下越薄越好。
- ◎加脂前确保涂脂部位的清洁干燥。
- ◎用辊轮、平整刮刀或者丝印刷上去，涂敷关键是要均匀、无气泡、无杂质。

## 包装形式

EXBOND 系列产品可以按照客户的要求装载。包装规格包括 1 cc、3cc、5cc、10cc、30 cc、1 盎司、1 磅。详细情况可以参考 Bonotec 标准包装数据或与当地的客户服务代表联系。

本产品对于皮肤敏感的人具有一定的致敏性，应避免皮肤直接接触。若不慎接触，请用肥皂和水冲洗，具体方法详见化学品安全说明书（MSDS, Material Safety Data Sheet）。

### 声明

上述的测量数据仅代表材料本身典型性能，不应当作为技术规格使用。本诺认为这些数据的测量和操作方式是精确的，但不能为其精确性做出保证。本诺建议用户在使用该产品前根据自己的操作方法和工艺条件判断其是否适合于特定的应用。本诺的工程师也将会帮助用户更好的使用该产品，满足用户应用要求。本诺从未授权任何人免除或改变上述条款。

---

上海本诺电子材料有限公司

地址：上海市闵行区瓶安路 1298 号（201109）

电话：021-5227 2688

<http://www.bonotec-adhesives.com>

传真：021-5227 2588

Email: [info@bonotec-adhesives.com](mailto:info@bonotec-adhesives.com)

第 3 页  
共 3 页